



BOLIX P

**klej do okładzin kamiennych oraz ciężkich płyt ceramicznych
(kolor szary)**

■ ZASTOSOWANIE:

Do przyklejania na powierzchniach pionowych i poziomych okładzin kamiennych (z wyłączeniem marmuru) oraz dużych, ciężkich płyt z gresu, klinkieru i płytek ceramicznych na podłoża z betonu, cegły, tynków cementowych i cementowo-wapiennych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków w tym również w pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgocenie (np. w kuchniach, łazienkach). Z uwagi na dużą wytrzymałość mechaniczną polecany do przyklejania okładzin kamiennych (z wyłączeniem marmuru), płytek ceramicznych, klinkierowych i gresowych na silnie obciążonych podłożach /np. posadzki przemysłowe, garaże, warsztaty itp/.

■ TECHNOLOGIA WYKONANIA:

■ Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być nośne, równe i suche, nie spękane, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tłuszcz, pyły i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podłoża o słabej przyczepności (odspojone tynki i powłoki malarskie) trzeba usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5÷15 mm) wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską BOLIX W. Podłoża chłonne należy zagruntować preparatem gruntującym BOLIX T. Gładkie powierzchnie betonowe zmatowić grubym papierem ściernym, odpylić i zagruntować preparatem BOLIX T.

■ Przygotowanie produktu:

Zawartość opakowania wsypać do pojemnika z odmierzoną ilością wody (4,75÷5,50 litra) i dokładnie wymieszać mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednolitej masy. Po upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia. Czas wykorzystania zarobionej wodą zaprawy wynosi ok. 1,5 h. Przygotowanie i aplikacja zaprawy wymaga temp. od +5°C do +25°C (dotyczy także podłoża)

■ Zastosowanie produktu:

Na właściwie przygotowanym podłożu nałożyć i rozprowadzić zaprawę klejową przy pomocy pacy zębatej (wym. zębów pacy dobrać odpowiednio do wielkości płytek), a następnie przyłożyć płytkę i docisnąć ją do podłoża. Zaprawa powinna pokrywać min. 80% powierzchni płytki. Po przyklejeniu płytki należy delikatnymi ruchami ustalić jej ostateczne położenie. Płytki można układać na zaprawie klejowej, póki zaprawa ma tendencję do przyklejania się do rąk (przed upływem czasu naszkórkowania). Korektę położenia płytek można przeprowadzić w czasie nie dłuższym niż 20 minut od momentu rozprowadzenia kleju na podłożu. Optymalna grubość warstwy klejowej wynosi 3÷5 mm /max. grubość 10 mm/. W przypadku posadzek, klej nakładać na podłoże i płytkę.

■ Zalecenia wykonawcze:

I) Przygotowanie podłoża

■ Na nowo wykonanych podłożach mineralnych (takich jak: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne) można rozpocząć prace przygotowawcze (w tym gruntowanie) i nakładanie zaprawy klejowej dopiero po jego wyschnięciu (okres schnięcia podłoża mineralnego wynosi ok. 8 dni na każdy 1 cm grubości warstwy).

■ W przypadku występowania nierówności i ubytków na powierzchni ścian i podłóg należy do ich wyrównania zastosować zaprawę klejową BOLIX W. Przy czym, jednorazowo można nakładać tą zaprawę warstwą o grubości do 15 mm.

■ W przypadku konieczności wyrównania i wygładzenia powierzchni podłóg (w zakresie od 2 do 10 mm) w pomieszczeniach bez ogrzewania podłogowego i nie narażonych na czasowe zawilgocenie zaleca się zastosować samopoziomującą zaprawę cementową BOLIX SN. Przed użyciem zaprawy samopoziomującej istniejące podłoże należy zagruntować aż do momentu całkowitej likwidacji chłonności podłoża preparatem głęboko penetrującym BOLIX N.

■ W miejscach występowania dużej wilgotności (kabiny prysznicowe, łazienki, pralnie, tarasy, balkony) w celu właściwego zaizolowania podłoża należy przed użyciem zaprawy klejowej wykonać powłokę uszczelniającą folią w płynie BOLIX HYDRO.

II) Aplikacja zaprawy klejowej

■ Proces przygotowania, układania i wiązania zaprawy klejowej powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze powietrza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotności powietrza.

■ Maksymalne obciążenie powierzchni pionowej okładziną kamienną nie może przekraczać 60kg/m².

■ W celu uzyskania dobrej przyczepności zaprawy do podłoża należy najpierw nanieść zaprawę klejową gładką stroną szpachli, a następnie nanieść zaprawę szpachlą zębatą o żądanej wielkości zębów.

■ Przy płytkach układanych na powierzchniach o małym obciążeniu zalecamy, aby nałożona zaprawa pokrywała min. 80% powierzchni spodu płytki.

■ Przy płytkach układanych na powierzchniach obciążonych oraz na płytkach układanych na zewnątrz zaprawa klejąca powinna pokryć 100% powierzchni wewnętrznej płytki.

■ W przypadku układania płytek na zewnątrz budynków zalecamy, aby zaprawę klejową nanosić metodą podwójnego smarowania (przesmarować zaprawą zarówno powierzchnię płytki jak i podłoże).

■ Należy odpowiednio dopasować możliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego wykonania (biorąc pod uwagę ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt, istniejący stan podłoża i panujące warunki atmosferyczne).

■ W trakcie prac należy pamiętać o właściwym wykonaniu i wykończeniu szczelin dylatacyjnych występujących w podłożu.



BOLIX P

**klej do okładzin kamiennych oraz ciężkich płyt ceramicznych
(kolor szary)**

III) Pielęgnacja i dojrzewanie zaprawy

- Świeżo przyklejone płytki chronić przed penetracją wody i działaniem mrozu do czasu związania zaprawy.

IV) Spoinowanie

- Spoinowanie wykonać najlepiej przy użyciu zaprawy do spoinowania BOLIX BK po ok. 72h od momentu przyklejenia płytek.

■ Środki ostrożności:

- Po zakończeniu klejenia narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą pamiętając, że po wyschnięciu zaprawy klejowej czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnię świeżo zabrudzonych elementów należy przetrzeć wilgotną szmatką.
- Wyrób posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem.

■ Niezbędne narzędzia:

- Wiadro budowlane
- Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr/min) z mieszadłem koszykowym
- Paca ząbkowana (wielkość ząbków kwadratowych powinna być odpowiednio dobrana do wielkości układanych płytek np. dla płytki 15 x 15 cm - ząbki 6 mm dla płytki 30 x 30 cm - 8 mm)
- Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej

■ DANE TECHNICZNE:

- Parametry użytkowe zaprawy klejowej:
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
- Temperatura podłoża: od +5°C do +25°C
- Proporcje mieszania: 4,75÷5,50 l wody na 25 kg kleju
- Czas użycia: ok. 1,5 h
- Optymalna grubość warstwy: 3÷5 mm
- Przyczepność: > 1,0 MPa
- Czas otwarty: ok. 20 min.
- Spływ: < 0,50 mm
- Obciążenie przez chodzenie: po 48 h
- Pełne obciążenie: po 14 dniach
- Spoinowanie okładzin kamiennych: po 72 h

■ Dane techniczne i właściwości produktu:

- Konsystencja: suchy proszek
- Kolor: szary
- Gęstość nasypowa: ok. 1,50 kg/dm³

■ Właściwości zaprawy:

- Odporność na wilgoć: okresowo odporna
- Odporność na starzenie: odporna
- Odporność na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna

- Odporność na kwasy i zasady: nie odporna

- Odporność na temperaturę: od -20°C do +50°C

/wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i temperatury powietrza + 20°C/

■ ZUŻYCIE:

Średnie zużycie zaprawy klejowej na odpowiednio przygotowanym podłożu wynosi ok. 0,85 kg/m² na każdy 1 mm grubości warstwy. W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu.

■ WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU:

Oryginalnie zamknięte opakowania chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania. Okres przydatności do zastosowania: do 12 miesięcy od daty produkcji. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

■ DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE:

- Norma PN-EN-12004
- Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/1214/15/2001
- Deklaracja zgodności Nr 2/EC/2004

■ SKŁAD:

Klej BOLIX P jest suchą mieszanką spoiw hydraulicznych, polimerów, bazy drobnopiękistych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących.

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.

Bolix S.A. ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec
tel.: /+ 48 33/ 475 06 00, fax: /+ 48 33/ 475 06 12

www.bolix.pl

data aktualizacji: 2006-09-20